

国泰海通证券股份有限公司

关于芯联集成电路制造股份有限公司

2025 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：芯联集成
保荐代表人姓名：徐亦潇、宋轩宇	被保荐公司代码：688469

重大事项提示

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）上市时未盈利且尚未实现盈利，2025 年度公司实现营业收入 81.80 亿元，实现 25.67% 的高速增长；全年毛利率 5.51%，同比提升 4.48 个百分点；归母净利润同比大幅减亏 38.17%，亏损收窄至-5.95 亿元，盈利能力显著改善。

截至报告期末，公司尚未实现盈利。主要系报告期公司尚处于产线建设初步完成、市场拓展快速增长阶段，产品结构尚未完全优化，规模效益未完全体现。基于当前强劲的市场需求增长趋势，产品结构的持续优化，碳化硅、模拟 IC 以及功率模块等高附加值业务占比提升，且随着时间推移设备折旧压力逐步降低，为公司盈利改善提供了核心动力。展望未来，公司将完成从芯片代工到系统级方案提供者的全面升级，实现对汽车、AI 服务器、工控及高端消费等关键领域的全覆盖，成为赋能全球新能源与智能化产业的核心力量。

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]548 号）批复，公司首次公开发行 A 股 194,580.00 万股（超额配售选择权全额行使），每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,160.20 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,078,341.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期

间为 2023 年 5 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2025 年度持续督导情况报告如下：

一、2025 年保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。

项目	工作内容
<p>7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
<p>8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>	<p>保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>
<p>9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。</p>	<p>保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。</p>
<p>10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露现场核查报告。</p>	<p>本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项目	工作内容
<p>12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；（二）资产被查封、扣押或冻结；（三）未能清偿到期债务；（四）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；（二）核心技术人员离职；（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；（四）主要产品研发失败；（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）所持上市公司股份被司法冻结；（二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的；（三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>	<p>保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>
<p>16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，并出具《国泰海通证券股份有限公司</p>

项目	工作内容
	司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的核查意见》。
17、保荐机构发表核查意见情况。	<p>2025 年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：2025 年上半年，保荐机构发表核查意见具体情况如下：2025 年 4 月 29 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》；2025 年 4 月 29 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；2025 年 4 月 29 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见》；2025 年 4 月 30 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告》；2025 年 4 月 30 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告》；2025 年 5 月 20 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的核查意见》。2025 年 7 月 3 日保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司为控股子公司申请贷款提供担保的核查意见》。2025 年 8 月 16 日保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》。2025 年 9 月 13 日保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司拟对外出售资产暨关联交易的核查意见》。2025 年 10 月 28 日保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。2025 年 10 月 28 日保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司使用部分闲置募集资</p>

项目	工作内容
	金进行现金管理的核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐机构开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

（一）尚未盈利的风险

公司所处的晶圆代工行业系技术密集型和资本密集型行业。目前公司尚处于规模扩张期，规模效应尚未完全释放，产品结构仍在持续优化，因此公司尚未盈利。公司将通过优化产品结构、提升技术竞争力，改善盈利能力。同时，不断提升技术研发和生产管理效率。在经营规模快速增长的同时，公司的市场渗透率稳步提升、合作伙伴生态日益丰富、技术团队专业能力持续增强，为公司盈利能力的改善构筑了坚实的基础。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

因市场需求的增长及公司产能的不断攀升，公司产品产出和销售量均逐年提升。如在后续的扩产过程中，出现宏观环境恶化、行业周期导致下游需求不足，亦或公司未能按计划推动客户验证及客户开发进度，可能导致公司未来收入出现下滑的风险。

（三）核心竞争力风险

1、产品研发与技术迭代风险

半导体产业技术及产品迭代速度较快，公司的发展在很大程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以生产出符合客户要求且具有较好成本效益的产品。为保证公司产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，公司在研发方面投入大量资金与人力资源。由于半导体行业的特殊性，公司未来仍然面临着产品迭代速度过快、研发周期长、资金投入大的风险，如果公司的技术与工艺未能跟上

竞争对手，新技术、新工艺的升级受阻，下游客户的需求发生难以预期的变化，可能导致公司产品被赶超或替代，前期的各项成本投入无法收回，进而在新产品领域难以保持市场的领先地位。

2、公司规模扩张与核心技术人员流失带来的管理风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着半导体行业对专业技术人才的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。公司资产规模、业务规模和员工数量均快速增长的同时，公司各项业务将会进一步快速扩张。公司规模快速扩张会使得公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的管理水平将提出更高的要求。若公司未能及时有效应对公司规模扩张带来的管理问题，可能会面临一定的管理风险。

（四）经营风险

1、行业周期风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于国际关系等因素引致下游市场整体波动，亦或由于中国半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

2、主要原材料市场集中风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片、光刻胶、化学品、气体、靶材、引线框等等。原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。公司的一些重要基础原材料如大尺寸硅片、光刻胶等上游行业呈现集中度较高的市场格局，使公司在采购该等原材料时供应商集中度也相对较高。同时，由于其他不可抗力等因素的影响，原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司出现不能及时获得足够原材料供应的状况，公司的正常生产经营可能会受到影响。

3、知识产权风险

作为一家科技型企业，公司的知识产权优势是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素之一。公司的专有技术、商业机密、专利或集成电路布图设计存在被盗用或不当使用的风险，也不排除现有知识产权被监管机构宣告无效或撤销，以及和竞争对手产生其他知识产权纠纷，这些情况都会对公司的业务开展产生不利影响。同时，公司在全球范围内销售产品，不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，从而影响国际化业务的开展。

（五）财务风险

1、信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，主要客户及供应商均为国内外头部公司，规模较大，信用水平较高。但由于公司规模不断扩大，与公司交易的第三方众多，未来如果部分客户或者供应商的经营情况发生不利变化，可能会面临应收账款回款或采购交付的信用风险。

2、汇率波动风险

人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，国际收支及外汇储备、利率、通货膨胀等均会对汇率造成一定的影响。公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，但公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率产生的影响程度，因此，人民币汇率的波动可能对公司的流动性和现金流造成不利影响。

（六）行业风险

近年来，随着国内半导体市场需求的不断扩大，半导体行业呈现快速扩张的趋势。但由于国内行业整体发展历程较短，市场需求仍在平衡中，国内半导体行业的生态管理仍需持续推进。目前，半导体行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力支持，但若未来相关部门出台的法律法规、行业标准、产业政策、出口政策等对公司产品及业务造成限制，则公司盈利能力及持续发展将受到不利影响。

（七）宏观环境风险

受到全球宏观经济波动、行业景气度、国际关系等因素影响，半导体行业存在一定的周期性。由于半导体行业受下游及终端应用市场需求波动的周期性影响，如未来宏观经济疲软，终端应用市场的需求尤其是增量需求下滑，客户将会减少产品的采购，行业将面临一定的波动风险。

四、重大违规事项

2025年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	817,973.29	650,909.08	25.67	532,448.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	788,940.13	627,608.29	25.71	491,073.95
利润总额	-193,257.64	-224,650.33	减亏 13.97%	-294,142.88
归属于上市公司股东的净利润	-59,489.30	-96,215.96	减亏 38.17%	-195,833.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,872.26	-140,956.02	减亏 20.63%	-226,168.58
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	217,756.58	214,571.36	1.48	92,541.68
经营活动产生的现金流量净额	213,460.87	190,262.04	12.19	261,430.16
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,303,436.21	1,232,101.39	5.79	1,248,307.47
总资产	3,318,098.63	3,420,272.38	-2.99	3,157,036.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
毛利率(%)	5.51	1.03	增加 4.48 个百分点	-6.81
净利率(%)	-23.63	-34.51	不适用	-55.24

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)	2023 年
息税折旧摊销前利润率 (%)	26.62	32.96	减少 6.34 个百分点	17.38
基本每股收益 (元 / 股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.15	-0.20	不适用	-0.37
加权平均净资产收益率 (%)	-4.95	-7.97	增加 3.02 个百分点	-22.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.30	-11.67	增加 2.37 个百分点	-25.91
研发投入占营业收入的比例 (%)	23.76	28.30	减少 4.54 个百分点	28.72

注:本期研发投入为本期费用化的研发费用与本期资本化的开发支出之和。

(三) 公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因：一方面，公司积极开拓市场与拓展产品线，持续推动技术和生产工艺迭代，一站式系统代工平台的协同效应日益显现，驱动营业收入规模快速扩大。另一方面，公司持续推进精细化运营管理，产能利用率保持较高水平。随着生产规模扩大，折旧摊销等固定成本得以有效摊薄，公司整体盈利水平同步增强。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 一站式系统代工服务的商业模式

公司为客户提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统代工服务，高效整合制造端与封测端的优势，切实解决芯片代工制造中的诸多痛点，有效提升了产品的安全性与可靠性，大幅缩短了产品从制造到封装测试的周期，确保产品交付的准时性，也让终端客户的责任划分更加清晰，显著降低客户的显性和隐性成本。同时，依托一站式系统代工服务的核心优势，公司同步延伸系统方案服务能力，可结合客户具体应用场景，提供适配的定制化系统方案，进一步满足客户从单一芯片代工到系统级解决方案的全方位需求，强化服务竞争力。

借助一站式系统代工服务的模式，公司不断拓宽客户种类。除传统的设计公

司外，公司也与诸多终端主机厂和系统公司进行了深度合作，实现了丰富、有纵深的客户布局，进一步提升客户合作黏性与市场竞争力。

（二）以四大核心技术为基石构建四大收入增长引擎，重点布局 AI（人工智能）领域实现业务多元化发展

公司坚持自主研发，从功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向出发，构建了汽车、AI（人工智能）、高端消费、工控四大收入增长引擎，形成了均衡且多元的业务结构，保持了公司持续的增长动力。

公司敏锐把握 AI（人工智能）技术的发展趋势，将 AI（人工智能）作为公司重点布局的新兴领域，持续加强在 AI 服务器电源、数据中心、机器人等相关产品的开发和验证。在 AI 服务器电源领域，公司开发的 55 纳米高效率电源管理芯片平台技术已获得重大突破，该技术可提升数据中心的能效比并降低运营成本。同时公司利用在氮化镓和碳化硅等第三代半导体材料方面的技术积累，为 AI 服务器电源系统提供了更高功率密度和转换效率的解决方案。

（三）研发团队深耕前沿技术并积极推动科技创新

公司坚持自主研发的路线，重视研发体系建设，在“市场+技术”双轮驱动的发展战略下，持续研发先进的工艺及技术，提供多样化的晶圆代工和模组封装等系统代工方案。报告期内，公司持续保持高额的研发投入，在人工智能、新能源等前沿技术领域积极推动科技创新，全力促进成果转化。2025 年公司研发投入 19.43 亿元，占营业收入 23.76%。

公司汇聚了一支技术实力深厚、经验丰富的研发团队，报告期内，公司研发人员合计 1226 人，比去年增加 283 人。其中，硕/博研究生 761 人，比去年增加 226 人。研发团队的核心成员均为行业内深耕数十年的资深研发技术人员，其卓越的专业能力和创新能力为公司带来了源源不断的技术突破和创新发展，成为了公司持续进步和行业领先的重要保证。报告期内，公司新增获得发明专利等 158 项，累计已获得发明专利等知识产权 574 项。同时公司通过多元化合作与自主创新相结合的方式，在 AI 数据中心、人工智能等多个重点领域开展前瞻性技术布局，不断巩固行业领先的技术研发优势。

（四）构建车规级供应商管理体系保障供应链稳定

公司构建并实施了符合车规级标准的供应商管理准入体系，建立了完善的供应商绩效评估机制，实现了对供应商的全生命周期管理。在质量改进、市场份额分配、升降级制度等关键环节，形成了系统化、规范化的管理体系，确保供应链的稳定性和可靠性。

在关键业务领域，公司已与国内外主流供应商建立了紧密的战略合作关系，共同应对市场变化和策略调整，为公司的长期稳健发展提供了有力支撑。通过持续推进直接材料和关键零部件的多元化项目，公司已实现国内领先的多元化供应链布局。此外，通过与核心战略供应商的深度协作，公司获得了高优先级的服务支持和具有成本竞争力的长期合作方案，为持续发展奠定了坚实基础。

（五）拥有完整的车规级研发量产平台和全流程车规级质量管理体系

公司是国内少数具备车规级功率芯片及模组和数模混合高压模拟芯片生产能力的代工企业，拥有种类完整、技术先进的车规级功率器件和功率 IC 研发及量产平台，是国内重要的车规、高端工业控制等核心芯片及模组制造基地。

公司拥有高效的数字化、车规级智慧工厂，在提高生产效率、保证产品质量以及降低运营成本方面发挥着重要作用。公司的车规级智慧工厂遵循严格的质量管理体系标准，并引入 AI（人工智能）辅助缺陷判断等先进的质量管理工具和方法以进一步提升质量水平。通过深化全流程质量管理，使产品质量具有卓越的稳定性和可靠性，从而获得更多客户定点。同时公司持续推进 IPD（集成产品开发）变革项目，优化产品开发流程，提升产品质量和研发效率。

公司攻克了各种可靠性、安全性的技术难题，已建立从研发到大规模量产的全流程车规级质量管理体系，通过了 ISO9001（质量管理体系）、IATF16949（汽车质量管理体系）等一系列国际质量管理体系认证，以及 ISO26262（道路车辆功能安全体系）体系认证。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	183,820.82	184,194.82	-0.20
资本化研发投入	10,506.67	不适用	不适用
研发投入合计	194,327.49	184,194.82	5.50
研发投入总额占营业收入比例（%）	23.76	28.30	减少 4.54 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	5.41	0.00	5.41

公司坚持自主研发，从功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向出发，构建了汽车、AI（人工智能）、高端消费、工控四大收入增长引擎，形成了均衡且多元的业务结构，保持了公司持续的增长动力。

公司坚持自主研发的路线，重视研发体系建设，在“市场+技术”双轮驱动的发展战略下，持续研发先进的工艺及技术，提供多样化的晶圆代工和模组封装等系统代工方案。报告期内，公司持续保持高额的研发投入，在人工智能、新能源等前沿技术领域积极推动科技创新，全力促进成果转化。2025 年公司研发投入 19.43 亿元，占营业收入 23.76%。

公司汇聚了一支技术实力深厚、经验丰富的研发团队，报告期内，公司研发人员合计 1226 人，比去年增加 283 人。其中，硕/博研究生 761 人，比去年增加 226 人。研发团队的核心成员均为行业内深耕数十年的资深研发技术人员，其卓越的专业能力和创新能力为公司带来了源源不断的技术突破和创新发展，成为了公司持续进步和行业领先的重要保证。报告期内，公司新增获得发明专利等 158 项，累计已获得发明专利等知识产权 574 项。同时公司通过多元化合作与自主创新相结合的方式，在 AI 数据中心、人工智能等多个重点领域开展前瞻性技术布局，不断巩固行业领先的技术研发优势。

(二) 在研项目

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	BCD 工艺技术 技术研发	1.发布 SOIBCD 高压平台技术, 客户产品验证中 2.发布 90 纳米高压 BCD 平台技术 3.发布 55 纳米 BCD 新一代平台技术, 客户产品验证中	1.SOIBCD 高压平台, 满足新能源汽车和储能电池管理应用需求 2.90 纳米高压 BCD 开发完成, 满足新能源汽车和 AI 服务器 48V 系统应用需求。 3.55 纳米 BCD 平台, 满足垂直化和小型化需求, 产品验证完成, 工艺达到国际领先水平	国际领先	1.SOIBCD 平台, 应用于汽车 BMSAFE 和工业系统集成芯片方案 2.90 纳米 BCD 平台, 应用于数模混合 IC 包括音频、数字电源、马达驱动、协议芯片和电源管理芯片 3.55 纳米 BCD 平台, 应用于 AI 服务器多项电源和 AI 加速卡和 AI 显卡
2	3.0 代 SiC 沟槽 MOSFET 研发	下一代 SiC 沟槽栅平台平台建设, 基于 750V/1200V 不同电压平台产品, 产品完成性能测试	国际领先工艺技术开发成功, 具备规模化的晶圆制造能力	国际领先	应用于工控、新能源车的高可靠性、高性能 SiCMOSFET 芯片
3	2.0 代 SiC 平面 MOSFET 研发	发布第二代 SiCMOSFET 晶圆产品, 完成客户端验证	性能和可靠性达到国际领先水平	国际领先	应用于工控、AI 服务器电源、乘用车的高可靠性、高性能 SiCMOSFET 芯片
4	SiCMOSFET 技术研发	8 英寸 SiCMOSFET 进入规模量产	全球第二条、国内首条 8 英寸 SiC 晶圆线量产, 性能达到国际同类厂商水平, 提供高质量高性能的量产平台	国际领先	应用于工控、AI 服务器电源、乘用车的高可靠性、高性能 SiCMOSFET 芯片
5	新一代沟槽型场截止 IGBT 技术开发	车载应用第三代沟槽型场截止 IGBT 技术完成开发, 650V-1700V 产品全面布局	完成客户端产品导入, 大规模量产, 器件性能达到国际领先水平。	国际领先	产品应用于新能源汽车电控/车载充电机/车载空压机等
6	逆导 IGBT 技术研发	650-1350V 电压等级产品全系列进入规模量产	性能达到国际同类厂商水平, 已进入量产状态	国际领先	白色家电空冰洗变频驱动、电源 PFC、IH 感应加热等
7	塑封车载模块技术研发	第三代单面散热塑封模块实现开发并完成头部客户送样	单面塑封车载模块实现 IGBT 和 SiC 模块量产, 满足客户高性能高可靠性的需求	国际领先	产品应用于新能源汽车电控
8	灌封车载模块技术研发	新一代紧凑型高性能灌封模块完成客户导入和量产, 产品覆盖 70KW 到 200KW 主流功率段	灌封模块实现自主研发+量产, 引领行业技术方向	国际领先	产品应用于新能源汽车电控
9	灌封工业光伏模块技术研发	完善 650V-2300V IGBT 以及 SiC 高效率芯片全系列芯片, 封装覆盖多种形式, 满足风光储充氢全应用场景要求	建设先进, 全面的产品谱系, 支持光储行业快速迭代发展	国际领先	光伏/储能逆变器, 风电变流器, 充电电源, 制氢电源, 电能质量

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
10	MCU 平台技术研发	1. 发布新一代 90 纳米 BCD60V/120V 嵌入式闪存工艺平台 2.55 纳米嵌入式闪存工艺平台开发完成, 满足车规高可靠性要求, 客户产品导入, 产品验证中	1.集成高可靠性嵌入式闪存工艺, 性能提升,满足新能源汽车最新一代 48V 系统需求 2.满足车规高可靠性以及成本要求	国内领先	1.广泛应用于车载小电机驱动, 车灯以及车身节点控制等 2.应用于车规 MCU, 工业 MCU 和安全芯片
11	MEMSmirror 光学传感器工艺平台开发	搭建 MEMS 光学平台, 产品送样验证中	研发 AI 数据中心用传输芯片, 填补国内空白	国内领先	应用于 AI 数据中心传输芯片等
12	车规级惯性 IMU 器件研发	第二代惯性传感器平台搭建完成, 产品送样验证中	研发高性能车载惯性传感器芯片, 填补国内空白	国内领先	应用于车载导航, 无人机等产品
13	消费类 IMU 惯性器件研发	1. 发布新一代 90 纳米 BCD60V/120V 嵌入式闪存工艺平台 2.55 纳米嵌入式闪存工艺平台开发完成, 满足车规高可靠性要求, 完成客户产品导入	1.集成高可靠性嵌入式闪存工艺, 性能提升,满足新能源汽车最新一代 48V 系统需求 2.满足车规高可靠性以及成本要求	国内领先	1.广泛应用于车载小电机驱动, 车灯以及车身节点控制等 2.应用于车规 MCU, 工业 MCU 和安全芯片
14	功率 GaN 技术研发	8 寸氮化镓平台工艺验证完成, 发布产品	产品覆盖高中低压,性能达到国际同类厂商水平	国内领先	应用于消费电子、数据中心、AI 服务器电源, 新能源汽车等
15	高质量语音识别和音频捕获麦克风技术研发	新一代高性能 MEMS 麦克风研发平台搭建完成, 产品送样完成	研发超高性能 MEMS 麦克风芯片, 填补国内空白	国内领先	应用于手机、可穿戴、智能语音交互等产品
16	IPM (SSC) 封装工程技术研发	完成全系列多规格产品开发, 部分产品在家电头部客户进入量产	性能达到国际同类厂商水平, 部分产品进入量产	国内领先	白色家电空冰洗、厨电、变频器、伺服等领域
17	12 寸超结 MOSFET 技术研发	多次外延超结新一代 MOSFET 平台开发完成, 多家客户导入开发产品	研发最新一代高功率超结 MOSFET, 性能成本优化	国内领先	应用于消费 LED、充电桩、服务器、光伏、车载等的高可靠性、高性能超结 MOSFET 芯片

注: 上述项目为公司截至报告期末的主要在研项目。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致 (如有)

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	1,107,160.20
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	28,818.50
二、募集资金净额	1,078,341.70
减：	
以前年度已使用金额	914,306.59
本年度使用金额	117,868.42
暂时补流金额	0
现金管理金额	57,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.54
加：	
募集资金利息收入	12,043.43
三、报告期期末募集资金余额	709.58

注：公司以自有资金支付了部分原计划以募集资金支付的发行费用,合计270.85万元，公司已将上述270.85万元永久补充流动资金。具体内容详见2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无控股股东和实际控制人，公司董事和高级管理人员均不存在直接持有股份的情形，其所持有公司股份亦不存在质押、冻结

或减持情况。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

保荐机构督促上市公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范资金和债务风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐机构提请投资者特别关注公司所处宏观环境风险。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

徐亦潇

宋轩宇

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日